

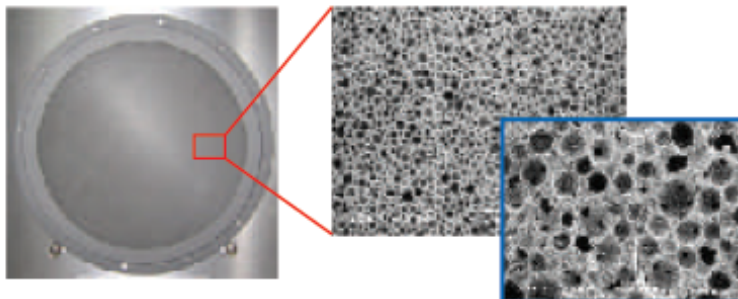
“CERASIC-BP” 多孔質SiC Porous SiC

“CERASIC-BP”は3次元網目構造を持ち、気孔率50～80%の範囲で制御可能な多孔質SiCです。また、当社独自の接合技術によりCERASIC（緻密質SiC）との接合が可能で、複合材料としての用途にも使用可能です。

“CERASIC-BP” is a porous SiC with a 3-dimensional mesh structure, controlling its porosity range of 50% to 80%. In addition, it can be bonded with standard CERASIC (non-porous), enabling other applications as a composite material as well.

- 最大形状:プレート 330×10mm •Max Size Availability: plate 330 x 10 mm
- 気孔率範囲: 50～80% •Porosity range: 50 to 80%

CERASIC-BP (気孔率60%) CERASIC-BP (Porosity 60%)



		CERASIC-BP			CERASIC	
		AP50	AP60	AP80	0.1以下	0.1 or less
Bulk density (g/cm ³)		1.60	1.20	0.65	3.15	
Bending strength (MPa)		80	50	10	450	
Thermal conductivity (W/mk)	25°C	74	43	16	170	
	200°C	51	30.	12	130	
Coefficient Thermal expansion (10 ⁻⁶ /°C)	-50°C	1.9	-	2.0	1.8	
	25°C	2.2	-	2.4	2.3	
	100°C	2.5	-	2.7	2.5	

CERASICの接合技術 CERASIC Bonding Technology

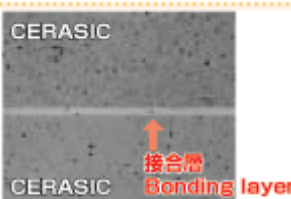
“CERASIC”は当社独自の接合技術により、中空構造や複雑構造への適用が可能です。このことにより、製品のさらなる軽量化、複雑形状化を実現しました。また、“CERASIC-BP”（多孔質SiC）との接合も可能で、あらゆる用途に対応します。

“CERASIC” can be adapted for complicated or hollow structure bodies with our unique bonding technology, and it achieves further miniaturization and complicated dimensions. Furthermore, “CERASIC” can be bonded to “CERASIC-BP” which expands its application range.

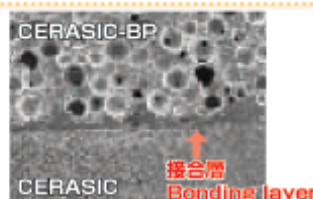
- 接合可能寸法: 1200mm •Sealable dimensions: 1200mm
- 接合部曲げ強さ: 200MPa (25°C) •Seal bending strength: 200MPa (25°C)



中空構造体モデル
Hollow Structural Model



CERASIC
CERASIC
接合層
Bonding layer
CERASICどおしの接合
CERASIC/CERASIC



CERASIC-BP
CERASIC
接合層
Bonding layer
CERASICとCERASIC-BP (多孔質)との接合
CERASIC/CERASIC-BP

TOSHIBA CERAMICS CO., LTD.

〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-3(日精ビルディング)
セラミック事業本部 URL: <http://www.tocera.co.jp>
TEL: 03-5437-8414
FAX: 03-5437-7395